2007-2008年中国硅材料行业分析及市场分析预测报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司 www.cction.com

一、报告报价

《2007-2008年中国硅材料行业分析及市场分析预测报告》信息及时,资料详实,指导性强,具有独家,独到,独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势,获得优质客户信息,准确、全面、迅速了解目前行业发展动向,从而提升工作效率和效果,是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址:http://www.cction.com/report/200806/1952.html

报告价格:纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人: 李经理

特别说明:本PDF目录为计算机程序生成,格式美观性可能有欠缺;实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

- 第一章 2007年全球硅材料市场概况
- 一、国际硅产业概述
- (一)国际硅产业概况
- (二)世界主要硅材料厂家生产情况
- (三)全球厂商争涉硅材料生产
- (四)硅材料短缺全球半导体市场增长恐受影响
- 二、全球硅材料市场规模与特点分析
- (一)2007年市场规模与增长
- (二) 硅材料市场特点分析
- 三、主要国家与地区发展概要
- (一)美国
- (二)欧盟
- (三)日本

第二章 2007年中国硅材料总体运行分析

- 一、经济发展环境分析
- (一)国内生产总值增长趋势
- (二)半导体制造业发展形势
- (三)固定资产投资状况
- 二、2007政策法规环境分析
- 三、中国硅材料市场现状分析
- (一)半导体行业带动硅材料发展
- (二)单晶硅大直径化稳步推进
- (三)太阳能电池为多晶硅带来市场
- 四、国内外硅片市场需求分析
- (一)全球硅片生产、销售、市场状况分析
- (二)世界分立器件及集成电路产业发展对硅片的市场需求
- (三)国内集成电路产业发展现状及对硅片市场的需求
- (四)国内集成电路用硅片市场供需及平均价格水平
- 五、硅材料行业经济运行分析
- (一)2007年行业经济指标运行

- (二)硅材料进出口贸易现状
- 1、太阳能级硅出口欧美市场成倍增长
- 2、"三友化工"成功打入美国市场
- (三)行业盈利能力与成长性分析
- 六、国内硅材料在建及拟建项目列举
- (一)南玻集团投资宜昌多晶硅材料及太阳能电池产业项目
- (二)美国通用硅材料有限公司投建多晶硅项目落户南昌
- (三)上海投建牡丹江3000吨多晶硅项目
- (四)青海年产千吨多晶硅项目已破土动工

第三章 中国硅材料行业细分市场发展分析

- 一、2007中国半导体硅材料行业概况
- (一)半导体硅材料企业状况
- (二)半导体硅材料生产销售情况
- (三)半导体硅材料进、出口情况分析
- (四)半导体硅材料的发展特点
- 1、半导体硅材料生产的规模大
- 2、半导体硅材料的生产技术不断创新
- 3、硅材料生产重视研究资金投入并采用先进设备
- 二、国内单晶硅、硅抛光片和外延片生产企业现状及能力
- (一)国内单晶硅主要生产企业现状
- (二)国内硅抛光片和外延片生产量及生产能力
- 三、国内外多晶硅生产的现状、技术与市场前景
- (一)世界多晶硅生产情况
- (二)国内多晶硅的生产现状
- (三)国内多晶硅市场需求及预测
- (四)我国兴建多晶硅厂应注意的问题
- 四、中国太阳能电池用硅材料的发展现状与市场前景
- (一)国内太阳能用硅材料的生产现状
- (二)国内太阳能用硅材料的市场前景
- (三)太阳能用硅材料的发展趋势

第四章 中国硅材料市场竞争及优势企业运营分析

- 一、整体竞争格局分析
- (一)国内掀起多晶硅项目热潮,但国际厂商仍占据绝对优势
- (二)硅材料行业集中力量参与高层次竞争迫在眉捷
- (三)太阳能火暴令硅材料全球走红
- 二、本信越半导体集团(Shin Etsu)
- (一)公司简介
- (二)经营与财务状况
- (三)竞争优势
- (四)发展前景
- 三、三菱住友(SUMCO)
- (一)公司简介
- (二)经营与财务状况
- (三)竞争优势
- (四)发展前景
- 四、瓦克(Wacker)
- (一)公司简介
- (二)经营与财务状况
- (三)竞争优势
- (四)发展前景
- 五、MEMC
- (一)公司简介
- (二)经营与财务状况
- (三)竞争优势
- (四)发展前景
- 六、东芝陶瓷(Toshiba)
- (一)公司简介
- (二)经营与财务状况
- (三)竞争优势
- (四)发展前景
- 七、有研半导体材料有限公司
- (一)公司简介

- (二)经营与财务状况 (三)竞争优势 (四)发展前景
- 八、峨嵋半导体材料厂
- (一)公司简介
- (二)经营与财务状况
- (三)竞争优势
- (四)发展前景
- 九、宁波立立电子股份有限公司
- (一)公司简介
- (二)经营与财务状况
- (三)竞争优势
- (四)发展前景
- 十、天津市环欧半导体材料技术有限公司
- (一)公司简介
- (二)经营与财务状况
- (三)竞争优势
- (四)发展前景
- 十一、宁晋松宫半导体有限公司
- (一)公司简介
- (二)经营与财务状况
- (三)竞争优势
- (四)发展前景

第五章 中国硅材料生产工艺技术分析

- 一、硅材料生产的工艺技术
- (一)硅片的主要生产工艺技术
- (二)高纯多晶硅生产技术对比分析
- (三)单晶硅的制备原理
- (四)太阳能级多晶硅新工艺技术
- 二、中国硅材料生产技术进展
- (一)中国打破国外对多晶硅生产技术的垄断

- (二)太阳能级多晶硅生产技术获得突破
- (三)中国物理法提炼太阳能多晶硅取得进展
- (四)多晶硅片生产受到技术封锁

第六章 硅产业链下游产业发展

- 一、国际太阳能电池产业
- (一)全球太阳能电池市场分析
- (二)日本太阳能电池发展状况
- (三)德国太阳能电池产量增加导致价格下降
- (四)德国太阳能电池巨头登陆日本市场
- 二、中国太阳能电池产业
- (一)太阳能电池产业发展综述
- (二)中国太阳能电池市场尚未被唤醒
- (三)中国太阳能电池产业链状况
- (四)2007年太阳能光伏产业解析
- 三、半导体产业
- (一)中国半导体产业综合分析
- (二)核心技术缺失制约国内半导体分立器件行业发展
- (三)半导体产业面临的难题

第七章 2007-2010年中国硅材料行业发展前景展望与预测

- 一、发展环境展望
- (一)宏观经济形势展望
- (二)政策走势及其影响
- (三)国际行业走势展望
- 二、硅产业发展趋势展望
- (一)中国硅产业发展展望
- 1、多晶硅产量不足
- 2、单晶硅产量稳步增长
- (二)"十一五"期间硅产业将迎来快速发展黄金期
- (三)未来10年硅产业发展前景稳定
- 三、2007-2010硅材料市场前景预测

- (一)产品供需平衡预测
- (二)出口预测
- (三)未来竞争态势预测
- (四)产品价格走势预测

第八章 2007-2010年中国硅材料行业投资机会与风险分析

- 一、行业投资机会分析
- (一)中国将成为最有潜力的电子信息产品大市场
- (二)多晶硅需求量大幅增长
- (三)太阳能产业带热多晶硅投资
- 二、行业投资风险分析
- (一)竞争风险
- (二)经营风险
- (三)技术风险
- (四)期限风险
- 三、行业投资建议及策略
- (一)策略分析
- 1、抓住国内市场,发展集成电路用硅片并提高质量
- 2、中国半导体多晶硅短缺,应抓紧时机建成多晶硅厂
- 3、高度重视SOI材料研发与产业化
- 4、重视设备和配套材料的开发与生产
- (二)投资建议
- 1、分立器件用硅材料市场巨大
- 2、发展区熔硅片
- 3、大力发展外延片
- 4、继续发展太阳能用硅材料
- 5、积极发展锗硅材料

图表目录:(部分)

图表 多晶硅下游产业链

图表 2006-2007年世界各国生产太阳能电池的产量及构成比例

图表 偃师石英石化验标准

图表 2006-2007年全球太阳能级多晶硅需求量

图表 2007-2010年全球多晶硅产能预测

图表 2006-2007年中国硅材料市场需求量

图表 2006-2007年中国多晶硅的生产与需求

图表 中国多晶硅产业已建和在建的项目

图表 2007年中国太阳级晶体硅的生产能力和生产量

图表 2007年世界太阳能电池厂商产量所占市场比例

图表 高纯多晶硅生产技术对比

图表 制造太阳电池等级多晶硅的新技术

图表 国外多晶硅公司新技术发展趋势

图表 国内多晶硅生产现状

图表 西门子法和物理法的对比

图表 2006年全球太阳能电池生产产量分布

图表 2006-2007年全球硅材料市场规模

图表 2007年中国硅材料市场需求规模

图表 2007年中国硅材料市场产品需求结构

图表 2007年中国硅材料市场应用需求结构

图表 2007年中国硅材料市场尺寸需求结构

图表 2007年中国半导体领域用硅材料需求规模

图表 2007年中国太阳能领域用硅材料需求规模

图表 2006-2007年全球硅材料市场规模

图表 2007-2010年全球硅材料市场产品结构预测

图表 2007-2010年中国硅材料市场需求规模与增长预测

图表 2007-2010年中国硅材料市场供给预测

图表 2007-2010年中国硅材料市场价格走势预测

详细请访问: http://www.cction.com/report/200806/1952.html